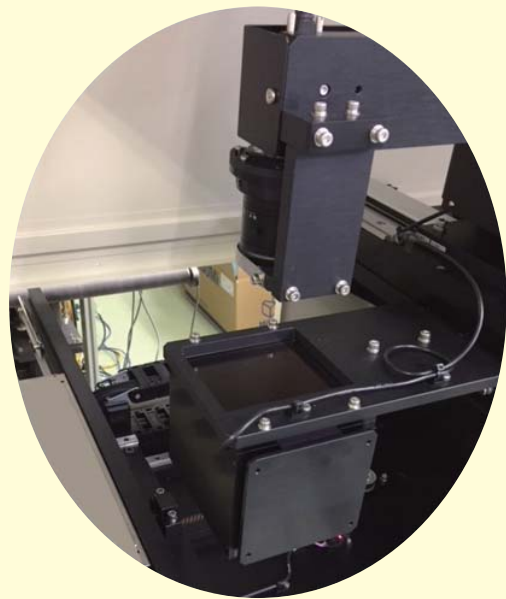


画像検査装置

【作業効率向上】 マスター登録基準位置セット自動化

【高精度】 位置検出精度アップで数 μ のズレを検出

【カスタマイズ可能】 お客様仕様でのカスタマイズ製作可能



仕様

ダイサイズ	Die Size	5.288 × 3.672 mm to 18.171 × 23.211mm
コア数	Number of dies	1,2,4
ダイの厚さ	Die Thickness	380 to 780 μ m
基板サイズ最大	Max Substrate Size	75×59mm
基板の厚さ	Substrate Thickness	0.55 to 2.04 mm
基準マーク	Fiducial Mark	ϕ 0.5 mm Circle, ϕ 1 mm Circle, 1 X 1 mm Square
検査項目	Inspection Item	Die : Angle, Offset Component (=Chip Capacitor) : Exist or Not Exist
カメラ数	# of Cameras	1
検査精度	Inspection Accuracy	\pm 10 μ m

お問合せ



株式会社アイ電子工業

<http://www.ailove.co.jp/>

栃木県那須塩原市鍋掛 1086 番地 18
TEL 0287-60-0057 FAX 0287-60-0162
E-mail aidenshi@ailove.co.jp